

2806120 Ohutkalvotekniikat
Tentti 1.9.2003

KIRJALLISUUDEN JA MUISTIINPANOJEN KÄYTTÖ KIELLETTY

1. Tavat tuottaa höyryvuo termisessä höyrystyspinnoituksessa. Soveltuvuus eri pinnoitemateriaaleille.
2. Seosmetallien terminen höyrystäminen ja sputterointi – tarkastele eroja eri prosessien kannalta.
3. RF-sputteroinnin periaate ja käyttö.
4. CVD-pinnoituslaitteiston osat. Eri CVD-prosessityypit, edut ja rajoitukset, sekä pinnoitusmahdollisuudet.
5. Ioni-implantointi pintakäsittelynä.
6. Lastuavien ja muovaavien työkalujen kovapinnoitteet ja niiden ominaisuudet, sekä tyypillisimmät kovapinnoitusprosessit.